

# تحضير أغشية $\text{SiC}_{1-X}\text{N}_X$ الرقيقة من تفاعل الطور الغازي المحت بليزر $\text{TEA-CO}_2$ ودراسة طبيعة الأوصار الكيميائية وبعض الخصائص البصرية والكهربائية

ماجدة علي أمين

تاريخ قبول النشر ٢٠٠٤/٧/٦

## الخلاصة

تم استخدام ليزر ( $\text{TEA-CO}_2$ ) النبضي لتفكيك جزيئات غازي السيللين ( $\text{SiH}_4$ ) والاثلين ( $\text{C}_2\text{H}_4$ ) فضلاً عن غاز الأمونيا ( $\text{NH}_3$ ) ضوئياً عن طريق الامتصاص متعدد الفوتونات المعزز بالتصادم مؤدية بذلك إلى تكوين أغشية ( $\text{SiC}_{1-X}\text{N}_X$ ) الرقيقة، وبقيم متعددة للعامل ( $X$ ) (0.33, 0.13, 0)، وتم ترسيب الأغشية على أرضيات من الزجاج بدرجة حرارة ( $K$ ) (648) وبمعدن ترسيب (nm/pulse) (0.416-0.833) (500-1000 nm). حددت طبيعة الأوصار الكيميائية للأغشية المحضرة من دراسة طيف نفاذية الأشعة تحت الحمراء ضمن المدى الطيفي ( $400-4000 \text{ cm}^{-1}$ ) باستخدام جهاز (FT-IR)، وتبين أن الأغشية تتكون من شبكة مركبة من ثلاثة عناصر هي (N, C, Si)، كما تحتوي في تركيبها على كمية من ذرات الهيدروجين فضلاً عن وجود أوصار كيميائية مختلفة مثل (N-H, C-H, C-C, N, Si-N) وغيرها. واستخدمت أطيفات الامتصاصية والنفاذية في مدى الأطوال الموجية (400-1100 nm) لدراسة بعض الخواص البصرية، فوجد أن فجوة الطاقة البصرية ( $E_0$ ) لأغشية ( $\text{SiC}_{1-X}\text{N}_X$ ) هي غير مباشرة وتزداد، بينما يقل عرض الحالات الموضعية ( $E_t$ ) داخلها، بزيادة العامل ( $X$ ). أظهرت دراسة الخواص الكهربائية للأغشية المحضرة نقصان توصيليتها الكهربائية (σ) وجود طاقتى تشغيل تزداد قيمتها بزيادة العامل ( $X$ ).

## المقدمة

(CW IR Laser) والمستمرة (Pulse IR Laser)، ومن بين هذه الأغشية، الأغشية المعدنية مثل (Cu, Al) وشبه الموصلة مثل (GaAs, Ge, Si) فضلاً عن الأغشية السيراميكية (العزلة) مثل ( $\text{Si}_3\text{N}_4$ ,  $\text{SiC}$ ) [3-5]. تعد أغشية (SiCN) المادة المعول عليها حالياً في التطبيقات الالكتروبصرية في منطقتي الأشعة فوق البنفسجية (UV) والمرئية (VIS) (تحديداً عند الطول الموجي الأزرق) وذلك لامتلاكها فجوة طاقة عريضة وخصائص الكتروبصرية ممتازة. ونظراً لامتيازها بالصلادة والخصائص الميكانيكية الممتازة ومقاومتها للعوامل المؤكسدة وللتآكل فهي تستخدم كاغطية وقائية للأقراص الصلبة (Hard Disk) وتتمكن تطبيقاتها بصورة كبيرة في تقنيات الطلاء والإلكترونيات الدقيقة (Microelectronics) [6-11]. تمكن فكرة البحث في تحضير أغشية

بعد اكتشاف الليزر في عام (١٩٦٠) حدثاً مهماً في مجالات تطبيقية عديدة منها الهندسية، الطبية، الصناعية فضلاً عن التطبيقات العسكرية وفي الاتصالات والتصوير المجمم، وكان للليزر أثر فعال في تطوير تقنيات مختلفة، ومن التطبيقات الحديثة للليزر استخدامه في حيث عمليات الترسيب المختلفة [1,2] والتي استخدمت في بحثنا هذا لترسيب أغشية رقيقة من مادة كاربونترید السليكون ( $\text{SiC}_{1-X}\text{N}_X$ ). إذ استخدم الليزر في السنوات الأخيرة في تكوين أغشية رقيقة عن طريق ترسيب البخار كيميائيا (Laser Induced Chemical Vapor Deposition (LICVD)) وحصل على اهتمام الباحثين، حيث تم تحضير أغشية متنوعة في مختبرات العالم المختلفة باستخدام ليزرات الأشعة فوق البنفسجية (UV Laser) وتحت الحمراء النبضية

تم استخدام جهاز (UV-VIS) ذو المدى الطيفي (200-1100 nm) لدراسة الخواص البصرية، كما تم استخدام عدة أجهزة لقياس الخواص الكهربائية منها {Digital Keithley 616 Electrometer} الذي يستخدم لقياس التيارات الواطنة وفرق الجهد والمقاومة، بالإضافة إلى طبيعة الأوصار الكيميائية وبالأخص (Oven Meemmert), 403 K ويستخدم لقياس درجة الحرارة للأغشية}. بينما حددت طبيعة الأوصار الكيميائية للأغشية المحضرة باستخدام جهاز Fourier Transform Infra Red Spectrometer (FT-IR) من (FT-IR Spectrometers moda 1700) وبالمدى الطيفي  $\text{cm}^{-1}$  (400-4000). ولغرض إجراء الفحص بهذا الجهاز تم تحضير قرص من مسحوق هذه الأغشية قطره (1.3 cm) وسمكه (0.7 mm) وذلك بمزج (2 mgm) من مسحوق أغشية ( $\text{SiC}_{1-x}\text{N}_x$ ) المحضرة مع (200 mgm) من مسحوق (KBr) الشفاف للأشعة تحت الحمراء ويكتب المزيج داخل قالب.

### النتائج والمناقشة

١- مطيافية الأشعة تحت الحمراء (FT-IR) لأحدى الطرائق الشائعة المستخدمة لقياس المحتوى الهيدروجيني والكشف عن التراكيب الجزيئية وطبيعة الأوصار الكيميائية، هي مطيافية الأشعة تحت الحمراء [8] (Fourier Transform Infra Red Spectrometer (FT-IR)). ولغرض تحديد طبيعة الأوصار الكيميائية وخاصة طريقة ارتباط ذرات الهيدروجين بكل من ذرات (N, C, Si) (50, 65, 75) mbar فضلاً عن ارتباط هذه الذرات بعضها البعض للأغشية ( $\text{SiC}_{1-x}\text{N}_x$ ) تم دراسة طيف نفاذية الأشعة تحت الحمراء لمسحوق هذه الأغشية المحضرة عند الضغط الأقل لغاز الامونيا (10) أي عند ( $X=0.13$ ) باستخدام الجهاز المذكور أعلاه وبالمدى الطيفي (400-4000) cm $^{-1}$ . كما مبين في الشكل (2)، إذ يتضح من موقع القعور (Dips) لطيف النفاذية {قم الامتصاص (Absorption Peaks)} في هذا الشكل أن هذه الأغشية تتكون من شبكة مركبة من ثلاثة عناصر هي (N, C, Si) فضلاً عن عنصر الهيدروجين (H) الناتج عن كل من غازات  $\text{SiH}_4$  و  $\text{C}_2\text{H}_4$  بالإضافة إلى غاز  $\text{NH}_3$  ، ووجود أوصار كيميائية مختلفة مثل (N-H, C-H, C≡N, C=N, C-N, Si-N) وغيرها من الأوصار الكيميائية التي تشير إلى هوية العناصر الدالة في تركيب هذه الأغشية يتم

كاربونترید السليكون ( $\text{SiC}_{1-x}\text{N}_x$ ) من تفكك غاز السيللين ( $\text{SiH}_4$ ) والاثلين ( $\text{C}_2\text{H}_4$ ) فضلاً عن غاز الأمونيا ( $\text{NH}_3$ ) ضوئياً عن طريق الامتصاص متعدد الفوتونات المعزز بالتصادم الذي يُحدثه ليزر (TEA-CO<sub>2</sub>) ومن ثم دراسة طبيعة الأوصار الكيميائية وبعض خواصها البصرية والكهربائية.

### الجزء العملي

تم تحضير أغشية كاربونترید السليكون ( $\text{SiC}_{1-x}\text{N}_x$ ) باستخدام المنظومة المبينة في الشكل (1)، حيث استخدم ليزر (TEA-CO<sub>2</sub>) البنضي وترتيب هندسي موازي (حرمة الليزر موازية للأرضية (substrate)، كمصدر لتجهيز المنظومة بالطاقة اللازمة لتكوين الأغشية المطلوبة. بعد تفريغ خلية الترسيب لغرض تنظيفها، تسخن الأرضيات الزجاجية (المراد ترسيب الأغشية عليها) لحين الوصول إلى درجة الحرارة المناسبة (648 K) بعدها يتم إدخال الغازات وبالضغط المطلوب (كما موضح في الجدول (1)), ثم تُعرض الغازات داخل الخلية إلى عدد كافي من نبضات الليزر، عندها تحدث عملية التبيح والتفكك متعدد الفوتونات لهذه الغازات مما يؤدي إلى تكوين الأغشية وبالنسبة المطلوبة، ثم تفرغ الخلية للتخلص من الغازات المتبقية (Residual gas).

شروط الترسيب المقترنة	
$T_s=648 \text{ K}$	درجة حرارة الأرض
(50, 65, 75) mbar	ضغط غاز $\text{SiH}_4$
(0, 20, 50) mbar	ضغط غاز $\text{NH}_3$
150 mbar	الضغط الكلي
10.6 $\mu\text{m}$	طول الموجي للليزر
10P(20)	خط العبات الليزر
1.5 J	طاقة نبضة الليزر
1200 نبضة	عدد نبضات الليزر
(500-1000) nm	سُك الأشعة
(0.416-0.833) nm/pulse	معدل الترسيب

وُحدَّد العامل (X) (الذي يمثل نسبة ذرات النتروجين في الأغشية) وفق العلاقة الآتية:-

$$X = \frac{P_{\text{NH}_3}}{P_{\text{SiH}_4} + P_{\text{C}_2\text{H}_4} + P_{\text{NH}_3}} \quad \dots \quad (1)$$

حيث:

$P_{\text{NH}_3}$ : ضغط غاز الامونيا

$P_{\text{SiH}_4}$ : ضغط غاز السيللين

$P_{\text{C}_2\text{H}_4}$ : ضغط غاز الاثلين

$$(a\hbar v) = B(hv - E_0)^r \quad (2)$$

حيث:

$\alpha$ : معامل الامتصاص ( $\text{cm}^{-1}$ )

$hv$ : طاقة الفوتون (eV)

$B$ : ثابت يعتمد على مقدار عشوائية الغشاء

$E_0$ : فجوة الطاقة البصرية (eV)

$r$ : معامل أسي

يوضح الشكل (3) تغير قيمة فجوة الطاقة البصرية ( $E_0$ ) للأغشية ( $\text{SiC}_{1-x}\text{N}_x$ ) العشوائية التركيب مع قيمة العامل ( $X$ ) ومن ملاحظة هذا الشكل يتبين أن فجوة الطاقة البصرية تزداد وتزاح نحو الطاقات العالية مع ازدياد قيمة العامل ( $X$ ، إذ وجد أن فجوة الطاقة البصرية للأغشية المحضررة عند عدم وجود غاز الامونيا ( $\text{NH}_3$ ) أي عند  $\{X=0\}$   $\{\text{SiC}, X=0\}$  تأخذ القيمة  $(1.6 \text{ eV})$  وتزداد لتأخذ القيمة  $(1.7, 1.8 \text{ eV})$  للأغشية المحضررة بوجود غاز الامونيا وبالضغط

$mbar$   $(20,50)$  أي عند قيم العامل  $\{[SiC_{0.87}N_{0.13}], X=0.13\}$ ,  $\{[SiC_{0.67}N_{0.33}], X=0.33\}$  على التالى، وكما موضح في

الشكل (4). يمكن أن تعزى زيادة فجوة الطاقة البصرية ( $E_0$ ) عند زيادة ضغط غاز الامونيا إلى عاملين مهمين أحدهما تفاعل أغشية ( $\text{SiC}$ ) مع النتروجين (أي زيادة المحتوى النتروجيني للأغشية المحضررة، والذي يعني زيادة ذرات النتروجين المرتبطة بالسليكون ( $\text{Si-N}$ ) والكربون ( $C-N$ ) والذي يعني وجود تجمعات من  $\text{SiN}$  و  $\text{CN}$  ضمن تركيب الأغشية) والتي تكون ذات فجوة طاقة أكبر من فجوة الطاقة لـ ( $\text{SiC}$ ). والأخر هدرجة هذه الأغشية (أي زيادة ذرات الهيدروجين المرتبطة بذرات السليكون ( $\text{Si-H}$ ) والنتروجين ( $\text{N-H}$ ) والكربون ( $\text{C-H}$ )) مما يعمل على تقليل الأواصر المتسلية (Dangling Bond) والتي يؤدي بدوره إلى تقليل الحالات الموضعية داخل فجوة الطاقة البصرية مما يعمل على زيادة قيمتها. إن زيادة قيم فجوة الطاقة البصرية ( $E_0$ ) بسبب زيادة ضغط غاز الامونيا ولكن مادة  $\text{SiC}_{1-x}\text{N}_x$  من المواد المقاومة للعوامل المؤكسدة وللتآكل، تؤكد لنا استخدامها في التطبيقات الالكتروبصريّة خاصة كنواذف لخلايا الشمسية. كانت نتائجنا متوافقة مع ما توصل إليه Machorro et al. [6]

[6] Machorro et al. [6]، إذ استخدموا طريقة التذرية وباستعمال ليزر ( $\text{KrF}$ ) في تحضير أغشية  $\text{SiC}_x\text{N}_y$  وعندها وجدوا أن فجوة الطاقة البصرية للأغشية المحضررة بالفراغ تأخذ القيمة  $(1.6 \text{ eV})$  وتزداد لتأخذ القيم  $(1.85, 2.3 \text{ eV})$

الاستدلال على وجود هذه الأواصر الكيميائية من خلال القبور (Dips) الظاهرة في طيف النفاذية (الشكل (2)) والتي تدل على وجود الأنماط الاهتزازية لهذه الأواصر. إذ يتضح أن الأغشية تحتوي على نترید السليكون ( $\text{SiN}$ ) الذي يمكن الاستدلال عليه من خلال قبور طيف النفاذية (قمة الامتصاص) المترکزة عند  $(440, 800 \text{ cm}^{-1})$  حيث إن القفتين ناتجتين عن نمط المط غير المتماثل (Asymmetric stretching vibration mode) [8,12] ( $\text{Si-N}$ )  $(1105, 1500, 2200 \text{ cm}^{-1})$ . القمم عند  $(1105 \text{ cm}^{-1})$  تدل بشكل واضح على احتواء الأغشية على كمية من الكربون [8,12] فالقمة عند  $(1105 \text{ cm}^{-1})$  ناتجة عن نمط اهتزاز الأصرة ( $\text{C-N}$ )، والقمة عند  $(1500 \text{ cm}^{-1})$  ناتجة عن وجود الأصرة ( $\text{C=N}$ ) أما القمة عند  $(2200 \text{ cm}^{-1})$  فهي تدل على ارتباط ذرة الكربون مع النتروجين بأصرة ثلاثية ( $\text{C}\equiv\text{N}$ ) وبنمط المط. كذلك أوضح طيف الأشعة تحت الحمراء المسجل احتواء الأغشية على كمية من الهيدروجين تم الاستدلال عليها من خلال القمم الطيفية المترکزة عند  $(2926, 3450 \text{ cm}^{-1})$  حيث القمة عند  $(2926 \text{ cm}^{-1})$  ناتجة عن مط الأصرة ( $\text{C-H}$ ) في ( $\text{Si-CH}_3$ ) [13,14]، والقمة عند  $(3450 \text{ cm}^{-1})$  والقريبة من التردد  $(3350 \text{ cm}^{-1})$  فهي ناتجة عن مط الأصرة ( $\text{N-H}$ ) [8,12]. القمة عند  $(940 \text{ cm}^{-1})$  تدل بشكل واضح على ان الأغشية تحوي على كمية من الأوكسجين، فهي ناتجة عن مط الأصرة ( $\text{O-H}$ ) في ( $\text{Si-OH}$ ) والذي قد يكون سببه تعرض النموذج إلى المحيط الجوي عند الفحوصات. وأخيرا القفتين عند  $(1403, 1660 \text{ cm}^{-1})$  فهما ناتجتان عن ( $\text{H}_2\text{O}$ ) الذي يحويه مسحوق الـ ( $\text{KBr}$ ).

## ٢- فجوة الطاقة البصرية ( $E_0$ )

تعتبر قيمة ونوع فجوة الطاقة البصرية عاملًا مهمًا في تحديد أهمية الكثير من النباتات الالكترونية كالخلايا الشمسية والكواشف لحساب فجوة الطاقة البصرية ( $E_0$ ) تم استخدام العلاقة (2)، حيث تم رسم العلاقة بين  $(\alpha\hbar v)^{1/r}$  وطاقة الفوتون ( $hv$ )، إذ تمثل ( $E_0$ ) قيمة الطاقة عند امتداد الخط المستقيم  $(\alpha\hbar v)^{1/r}$  vs.  $hv$ ) مع محور طاقة الفوتون وتم اختيار قيمًا مختلفة لـ ( $r$ ) وأفضل قيمة حفقت توائماً مع الخط المستقيم هي (2).

الكهربائية. تتفق نتائجنا مع [15]، Nagai et al. إذ وجدوا أن مقاومة أغشية  $\text{SiC}_X$  المحضرة في جو من النتروجين تتزداد وبسرعة كبيرة بزيادة كمية الغاز عند النسب الأعلى من (3%).

#### بـ طاقة التنشيط الكهربائية ( $E_a$ )

للغرض تحديد طاقة التنشيط الكهربائية ( $E_a$ ) لأغشية ( $\text{SiC}_{1-X}\text{N}_X$ ) المحضرة بوجود غاز الامونيا ( $\text{SiC}_{1-X}\text{N}_X$ )،  $\text{SiC}_{0.87}\text{N}_{0.13}$ ,  $\text{SiC}_{0.67}\text{N}_{0.33}$  وبعد وجوده ( $\text{SiC}$ )، تم رسم العلاقة بين ( $\sigma$ ) مع مقلوب درجة الحرارة وحسب العلاقة (4).

$$\sigma = \sigma_0 \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T}\right) \quad (4)$$

حيث:

$\sigma$ : التوصيلية الكهربائية المستمرة ( $\Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ )

$\sigma_0$ : ثابت

$E_a$ : طاقة التنشيط للتوصيلية الكهربائية (eV)

$k_B$ : ثابت بولتزمان

$T$ : درجة الحرارة المطلقة

والشكل (8) يوضح رسمًا لعلاقة  $\ln \sigma$  مع  $10^3/T$  للأغشية عند قيم مختلفة لـ  $X$ ، حيث يتضح منه وجود طاقتى تنشيط لكل قيمة من قيم ( $X$ ) وللمدى درجات الحرارة المقابلة التي تشير إلى وجود آيتين للتوصيل التي تؤدي بدورها إلى اختلاف نوعية التوصيل داخل الغشاء. فضمن مدى درجات الحرارة العالية ( $T > 370 \text{ K}$ ، التي تم فيها حساب طاقة التنشيط الأولى ( $E_{a1}$ )، يحصل التوصيل فيها بانتقال حوامل الشحنة إلى المستويات الممندة فوق الحافة الحركية وتحتها لكل من حزمتي التوصيل والتكافؤ على التالي أي إن الانتقال في مثل هذه الحالة يكون بمساعدة ذرات النتروجين (Thermal Activation) بينما يكون التوصيل

ضمن مدى درجات الحرارة الوطئة ( $T < 370 \text{ K}$ ، التي حسب عندها طاقة التنشيط الثانية ( $E_{a2}$ )، ناتجاً عن تقطط حوامل الشحنة المثارة بين المستويات المقيدة في الفجوة أي إن التوصيل يحدث بطريقة القفز أو الانتقال (Tunneling).

ولعرض توضيح تأثير ضغط غاز الامونيا (نسبة ذرات النتروجين (العامل ( $X$ )) في قيم طاقتى التنشيط لأغشية ( $\text{SiC}_{1-X}\text{N}_X$ ) المحضرة وفق العلاقة (4)، تم رسم طاقتى التنشيط ( $E_{a1}$ ) و( $E_{a2}$ ) كدالة للعامل ( $X$ )، كما موضح بالشكلين (9) و (10) على التالي، ونلاحظ من هذين الشكلين إن طاقة التنشيط تتزداد مع ازدياد ضغط غاز الامونيا أي تزداد بزيادة نسبة ذرات النتروجين في أغشية

عند تحضير الأغشية في جو من غاز النتروجين وعند الضغوط mTorr (10, 80) على التالي.

#### ٣- حساب عرض الذيل ( $E_t$ )

تم حساب طاقة أورباخ ( $E_t$ ) التي تمثل عرض ذيول الحالات الموضعية الموجودة داخل فجوة الطاقة باستخدام علاقة أورباخ وذلك من رسم العلاقة بين ( $\ln \alpha$ ) كدالة لطاقة الفوتون ( $h\nu$ ، حيث تمثل ( $E_t$ ) مقلوب ميل الجزء المستقيم.

$$\alpha = \alpha_0 \exp\left(\frac{h\nu}{E_t}\right) \quad (3)$$

حيث:

$\alpha$ : ثابت التنساب

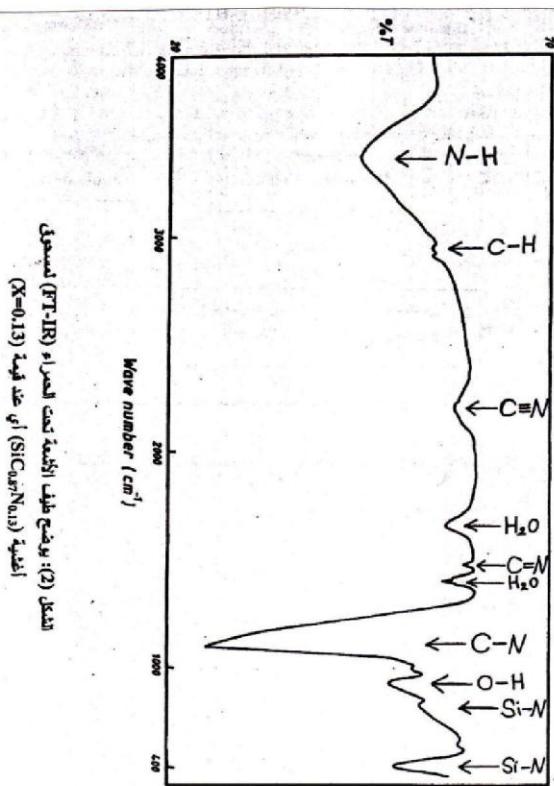
والشكل (5) يوضح هذه العلاقة لأغشية ( $\text{SiC}_{1-X}\text{N}_X$ ) المحضرة بوجود غاز الامونيا ( $\text{SiC}_{0.87}\text{N}_{0.13}$ ,  $\text{SiC}_{0.67}\text{N}_{0.33}$ ) وبعد وجوده ( $\text{SiC}$ )، إذ يوضح تغير ( $\ln \alpha$ ) مع طاقة الفوتون لهذه الأغشية، ونلاحظ من هذا الشكل أن عرض الذيول يقل بزيادة نسبة العامل ( $X$ )، وكما موضح بالشكل (6). والسبب في ذلك يعزى إلى زيادة قيم فجوة الطاقة البصرية بزيادة ضغط غاز الامونيا {أي بزيادة نسبة النتروجين (العامل ( $X$ ))} في الأغشية المحضرة وبالتالي نقصان عرض الحالات الموضعية داخلها. والجدول (2) يبين تغير قيم فجوة الطاقة وعرض الذيول دالة لنسبة ذرات النتروجين ( $X$ ) في الأغشية المحضرة.

معدل رقم (٢)		
( $\text{SiC}$ ), $X=0$	( $\text{SiC}_{0.87}\text{N}_{0.13}$ ), $X=0.13$	( $\text{SiC}_{0.67}\text{N}_{0.33}$ ), $X=0.33$
$E_b$ (eV)	$E_b$ (eV)	$E_b$ (eV)
1.6	1.7	1.8
$E_t$ (eV)	$E_t$ (eV)	$E_t$ (eV)
0.55	0.5	0.49

#### ٤- الخصائص الكهربائية

##### أ- التوصيلية الكهربائية ( $\sigma$ )

حدد تأثير ضغط غاز الامونيا {نسبة ذرات النتروجين (العامل ( $X$ ))} على مقدار توصيلية أغشية ( $\text{SiC}_{1-X}\text{N}_X$ )، إذ يتضح من الشكل (7) - الذي يمثل تغير توصيلية الأغشية في درجة حرارة الغرفة ( $\sigma_{RT}$ ) كدالة للعامل ( $X$ ) - إن توصيلية الأغشية تبدأ بالهبوط عند زيادة نسبة ذرات النتروجين فيها، والسبب في ذلك يعزى إلى ما ذكرناه سابقاً من حيث إن زيادة ضغط غاز الامونيا يؤدي إلى زيادة المحتوى النتروجيني للأغشية المحضرة وأحتواها على تجمعات من نترید السليكون ( $\text{SiN}$ ) الذي يسبب زيادة مقاومتها بسبب خواصه العازلة، ومن ثم نقصان توصيليتها



الشكل (٢): بوضوح طيف الأشعة تحت الحمراء لسموسي (FT-IR) أخذت على الأغشية (X=0.13) أو عديمة (X=0.0) المدعى (2).

( $\text{SiC}_{1-x}\text{N}_x$ )، إن سبب هذه الزيادة يعزى إلى زيادة عدد أواصر (Si-N) التي تعنى احتواء الأغشية على تجمعات من (SiN) بزيادة ضغط غاز الامونيا الذي يسبب زيادة مقاومتها وكذلك زيادة في فجوة طاقتها (التي تعنى نقصان كثافة الحالات الموضعية داخلها) وهذا يعني زيادة في طاقة التنشيط. وفيما يلي الجدول (٣) يوضح تغير قيم التوصيلية وطاقي التنشيط دالة لنسبة ذرات النتروجين (X) في الأغشية المحضررة.

موجول رقم (٣)		
$(\text{SiC})$ , X=0	$(\text{SiC}_{0.87}\text{N}_{0.13})$ , X=0.13	$(\text{SiC}_{0.67}\text{N}_{0.33})$ , X=0.33
$\sigma_{RT} (\Omega \cdot \text{cm})^{-1} \times 10^4$		
1.656	0.247	0.026
$E_g$ (eV)		
0.325	0.499	0.539
$E_a$ (eV)		
0.033	0.035	0.037

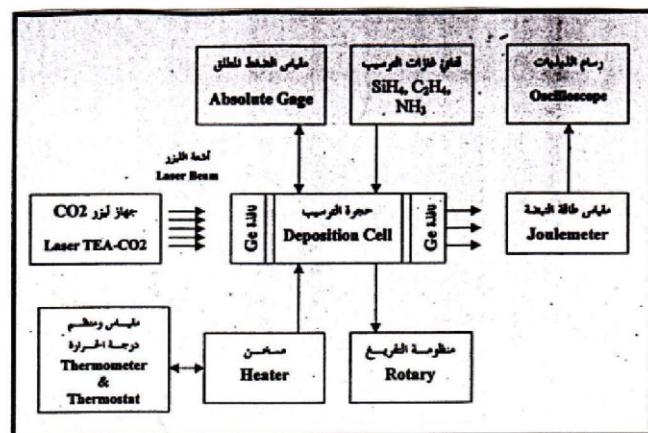
### الاستنتاجات

تلخص النتائج التي تم التوصل إليها بالآتي:-

١. ببنت القياسات التي أجريت باستخدام جهاز (FT-IR) على أغشية ( $\text{SiC}_{1-x}\text{N}_x$ ) إنها تكون من شبكة مركبة من ثلاثة عناصر هي (N, C, Si) ووجود أواصر كيميائية مختلفة تربط بين ذرات (H, N, C, Si) مثل (N-H, C-H, C-N, Si-N) وغيرها.

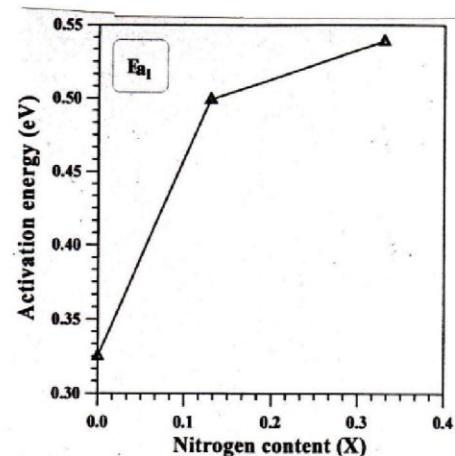
٢. زيادة فجوة الطاقة البصرية ( $E_0$ ) ونقصان عرض الحالات الموضعية ( $E_a$ ) بزيادة ضغط غاز الامونيا (نسبة ذرات النتروجين (العامل X)).

٣. ومن نتائج القياسات الكهربائية للأغشية ( $\text{SiC}_{1-x}\text{N}_x$ ) تبين نقصان توصيلية الأغشية وجود طاقتى تنشيط تزداد قيمتها، بزيادة ضغط غاز الامونيا.

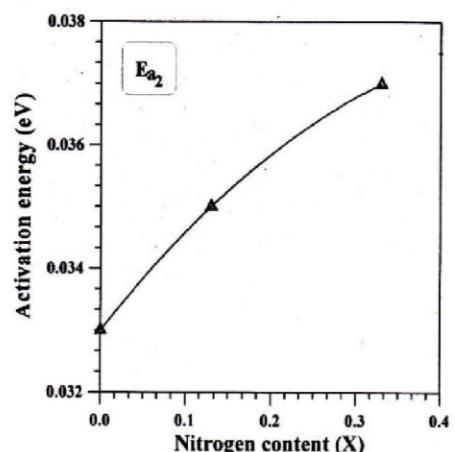


الشكل (٤): مختلط توضيحي للأجهزة المستخدمة في ترسيب أغشية ( $\text{SiC}_{1-x}\text{N}_x$ )

4. Drinek, V. & Pola J., 1994, "Laser-Induced Chemical Vapour Deposition of Silicon Carbide", "Ceramics-Silikaty", 38: 37.
5. Besling, W.F.A., vander Put P.J.J.M. & Schoonman J., 1995, "Laser-Induced Chemical Vapour Deposition of Silicon Carbonitride", "Journal DE Physique IV", 5: 953.
6. Machorro, R., Samano E.C., Soto G. & Cota L., 1998, "SiC<sub>x</sub>N<sub>y</sub> Thin Films Alloys Prepared by Pulsed Excimer Laser Deposition", "Appl. Surf. Sci.", 127-129: 564.
7. Chen, K.H., Wu J.-J., Wen C.Y., Chen L.C., Fan C.W., Kuo P.F., Chen Y.F. & Huang Y.S., 1999, "Wide Band Gap Silicon Carbon Nitride Films Deposited by Electron Cyclotron Resonance Plasma Chemical Vapor Deposition", "Thin Solid Films", 355-356: 205.
8. Xiao, X.-C., Li Y.-W., Song L.X., Peng X.-F. & Hu X.-F., 2000, "Structural Analysis and Microstructural Observation of SiC<sub>x</sub>N<sub>y</sub> Films Prepared by Reactive Sputtering of SiC in N<sub>2</sub> and Ar", "Appl. Surf. Sci.", 156: 155.
9. Hsieh, C. H., Huang Y.S., Ktong K., Fan C.W., Chen Y.F., Chen L.C., Wu J.J & Chen K.H., 2000, "Piezoreflectance Study of an Fe-Containing Silicon Carbon Nitride Crystalline Film", "J. Appl. Phys.", 87: (1) 280.
10. Hsieh, C. H., Huang Y.S., Kuo P.F., Chen Y.F., Chen L.C., Wu J.-J., Chen K.H. & Tiong K.K., 2000, "Piezoreflectance Study of Silicon Carbon Nitride Nanorods", "Appl. Phys. Lett.", 76: (15) 2044.
11. Wu, J.-J., Wu C.-T., Liao X.-C., Lu T.-R., Chen L.C., Chen K.H., Hwa L.-G., Kuo C.-T. & Ling K.-J., 1999, "Deposition of Silicon Carbon Nitride Films by Ion Beam



الشكل (9): يوضح تغير طاقة التنشيط ( $E_{a1}$ ) دالة للمحتوى النتروجيني (X) لأنغشية ( $SiC_{1-x}N_x$ )



الشكل (10): يوضح تغير طاقة التنشيط ( $E_{a2}$ ) دالة للمحتوى النتروجيني (X) لأنغشية ( $SiC_{1-x}N_x$ )

## References

1. Isenor, N.R. & Richardson M.C., 1971, "Dissociation and Breakdown of Molecular Gases by Pulsed CO<sub>2</sub> Laser Radiation", "Appl. Phys. Lett.", 18: (6) 224 .
2. Solanki, R., Moore C.A. & Collins G.J., 1985, "Laser Induced Chemical Vapor Deposition", "Solid State Technology", 28: (6) 220.
3. Herman, I.P., 1989, "Laser-Assisted Deposition of Thin Films from Gas-Phase and Surface-Adsorbed Molecules", "Chem. Rev.", 89: 1323.

- Magnetron Sputtering Method”, “Appl. Phys. A”, 38: 37.
14. Drienk, V., Bastl Z., Subrt J., Taylor R. & Pola J., 1995, “IR Laser-Induced Decomposition of Tetravinylsilane for Chemical Vapour Deposition of Si/C/H materials”, “Journal of Analytical and Applied Pyrolysis”, 35: 199.
15. Nagai, T., Yamamoto K. & Kobayashi I., 1983, “Effect of Nitrogen on the Electrical Properties of Sputtered  $\text{SiC}_x$  Films”, “Thin Solid Films”, 106: 303.
- Sputtering”, “Thin Solid Films”, 355-356: 417.
12. Misaki, H., Asano M., Kasai K., Fukuda M. & Imamura N., 1989, “Hydrogen-Containing SiCN Protective Films for Magneto-Optical Media”, “IEEE Transactions on Magnetics”, 25: (5) 4030.
13. Saito, N., Tanaka N. & Nakaaki I., 1985, “Optical, Structural, Electrical and Optoelectronic Properties of Hydrogenated Amorphous  $\text{Si}_{1-x}\text{C}_x$  Alloy Thin Films Prepared by Planar

## **$\text{SiC}_{1-x}\text{N}_x$ thin films preparation by TEA- $\text{CO}_2$ Laser induced Vapor-phase reaction and study of the nature of chemical bonds and some their electrical and optical properties**

**Majda Ali Ameen**

**Physics department-College of Science for Women-University of Baghdad.**

### **Abstract**

A pulsed (TEA-CO<sub>2</sub>) laser was used to dissociate molecules of silane (SiH<sub>4</sub>), ethylene (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>) and ammonia (NH<sub>3</sub>) gases, through collision assisted multiple photon dissociation (MPD) to deposit(SiC<sub>1-X</sub>N<sub>X</sub>) thin films, where the X-values are 0, 0.13 and 0.33, on glass substrate at T<sub>s</sub>=648 K, deposition rate of (0.416-0.833) nm/pulse and thickness of (500-1000)nm .Fourier transform infrared spectrometry (FT-IR) was used to study the nature of the chemical bonds that exist in the films. Results revealed that these films contain complex networks of the atomic (Si, C, and N), other a quantity of atomic hydrogen and chemical bonds such as (Si-N, C-N, C-H and N-H).Absorbance and Transmittance spectra in the wavelength range (400-1100) nm were used to study the optical properties of the deposited films. It was found the optical energy ap E<sub>0</sub>) of these films is indirect and increases with increasing (X) while the width of localized states decreases.The study of the electrical properties of the deposited films revealed that their electrical conductivity at any constant temperature decreases with increasing (X) and the films have two activation energies both increase with increasing (X).





